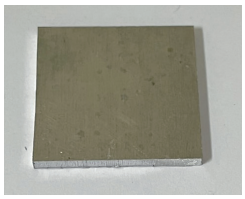
(주)진우테크

AI 시편 전처리

목적: 일정한 크기의 샘플 채취

주요 기술

1. Diamond Wire Saw 를 사용하여 샘플 손상을 최소화하여 채취
2. Slice 및 각도 조절 기능



샘플 이미지 (AI)

1. 장비 소개 (Cut D 203 Diamond Wire Saw)

특징

- 다양한 소재 및 부품 정밀 절단 가능
- 터치스크린을 통한 절단 조건 설정 가능
  - Z 축 및 Y 축 이동
    (이동가능거리 Z 축 :1~60mm, Y 축 : 0~50mm)
  - 각도 조절 (0~360°)
  - 작업대 기울기 조절
  - Slice (1~99)
  - 절단 속도 조절 (0.05~40.00mm/min)
- 절단 가능한 최대 사이즈 : 50x50mm

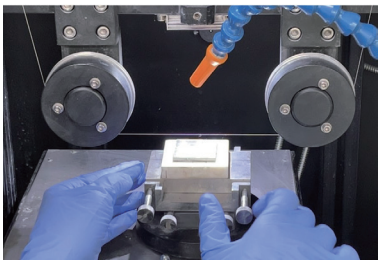
2. 샘플 준비 및 채취

1. Wax를 이용하여 지그 위에 샘플을 부착.

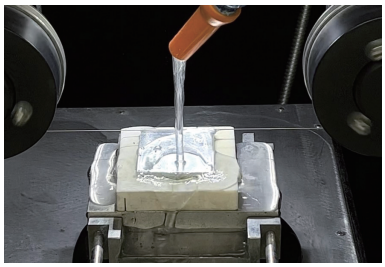
(주)진우테크

AI 시편 전처리

2. 홀딩 플레이트에 샘플이 부착된 지그를 고정.

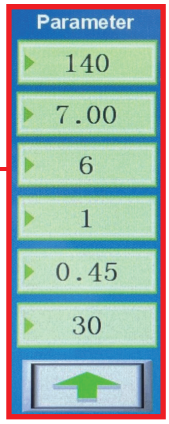


3. 터치스크린을 이용하여 절단하고자 하는 부분을 Diamond Wire 아래에 향하도록 위치 시킨 후 절단 진행.



설정 가능 값

절단 시작 전 원하는 절단 값 설정 가능



Spooler 회전 속도

Y 축 이동거리

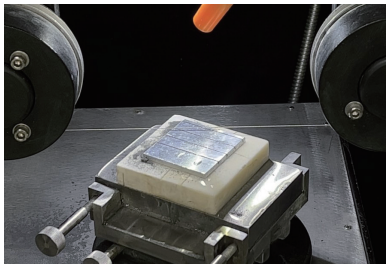
Z 축 이동거리

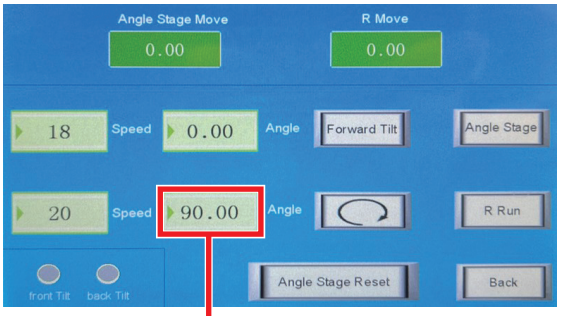
Slice 횟수

절단 속도

처음 위치로 돌아 오는 속도

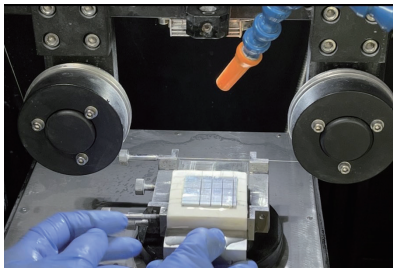
4. 각도 조절이 필요한 경우, 터치 스크린을 이용하여 조절 후, 절단 진행.



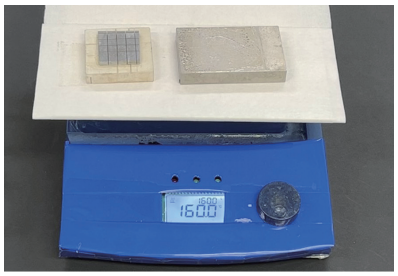


각도 조절 값 (0.01-180°) 까지 조절 가능

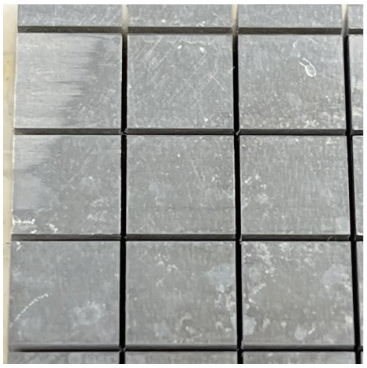
5. 절단이 완료되면 샘플이 부착된 지그를 장비에서 분리.



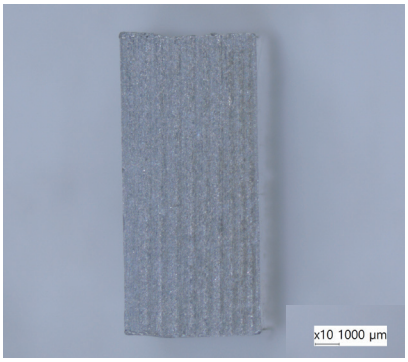
6. 핫플레이트 위에 지그를 올려 샘플 분리.



4. 결과



절단 후 샘플



절단 후 단면

❋ 일정한 크기로 절단 되었음을 확인

상세 기술자료, 소모품 샘플 및 기술 상담이 필요하시면,
(주)진우테크 시편전처리 센터로 연락 주시길 바랍니다.

email : info@chinwoo.co.kr
전화 : 031-777-1277